



Toshiba leverer nu automotive 40V MOSFET med ultralav Rds(on) i 5mm x 6mm kapslinger med dobbeltsidet køling

Nye huse forbedrer den termiske ydelse

Düsseldorf, Tyskland, 23. oktober, 2018 – Toshiba Electronics Europe lancerer nu “TPWR7940PB” og “TPW1R104PB”, begge 40V N-kanal power MOSFETs i DSOP Advance (WF) kapslinger med dobbeltsidet køling. TPWR7940PB er en 40V max 0,79mΩ MOSFET i DSOP Advance(WF)L-hus, mens TPW1R104PB er en 40V max 1,14mΩ MOSFET i DSOP Advance(WF)M-hus. Begge komponenter er baseret på den nyeste trench-struktur U-MOSIX-H proces og er AEC-Q101-kvalificerede. De er typisk rettet mod automotive applikationer som elektrisk power-styring (EPS), elektriske pumper og switche til kraftige belastninger.

Både DSOP Advance (WF)M og DSOP Advance (WF)L er 5mm x 6mm kapslinger med 8 pins. DSOP Advance (WF)M og DSOP Advance (WF)L er anderledes gennem deres blottede område på toppens metalplade. Dette område er omtrent 8mm² i DSOP Advance(WF)M-huse og 12mm² i DSOP Advance (WF)L-huset. Målt i Toshiba’s eget testmiljø er den maksimale kanal-til-topplade termiske ydelse 1,5K/W for TPW1R104PB og 0,93K/W for TPWR7940PB. Den fremragende termiske ydelse kan man opnå ved at montere det blottede metalareal til en køleplade (som et metalchassis) via et isolationslag.

DSOP Advance (WF)M og DSOP Advance (WF)L husene er footprint-kompatible med SOP Advance (WF)-kapslingen, der dog ikke har det blottede metalareal i toppen. DSOP Advance (WF)M og DSOP Advance (WF)L-husene har en wetable flanketerminalopbygning, der tillader AOI (Automatisk Optisk Inspektion) af komponentens lodninger på printet. AOI er især vitalt i automotive produktionsmiljøer, hvor en verifikation af loddekvaliteten er påkrævet.

Masseproduktion af både TPWR7940PB og TPW1R104PB er begyndt i august, 2018.

###

Om Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) er den europæiske komponentforretning af [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#). TEE tilbyder europæiske kunder og virksomheder et bredt udsnit af innovative hard disk drive (HDD) produkter samt halvlederløsninger til automotive-, industrielle- og IoT-applikationer, bevægelsesstyring, telecom, netværk samt forbruger- og hvidevareapplikationer. Virksomhedens brede portefølje omfatter integrerede trådløse IC'er, effekthalvledere, mikrocontrollere, optiske halvledere, ASICs, A SSPs samt diskrete komponenter lige fra dioder til logik-IC'er.

TEE har hovedkvarter i Düsseldorf, Tyskland, med kontorer i Frankrig, Italien, Spanien, Sverige og United Kingdom, hvorfra der udføres design, produktion, marketing og salg. Virksomhedens administrerende direktør er Hr. Tomoaki Kumagai

For mere information besøg venligst Toshiba Electronics Europe's website på www.toshiba.semicon-storage.com.

Kontaktoplysninger til publikation:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com

Redaktionelle kontaktpersoner for yderligere information:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Udsendt for Toshiba Electronics Europe af:

Birgit Schöniger, Publitek

Tlf: +44 (0) 20 8429 6554

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Oktober 2018

Ref. 7166/A